

# 2018年3月期 第3四半期（2017年10月～12月） 東京エレクトロン 決算説明会

2018年1月30日

内容：

- 第3四半期連結決算の概要 代表取締役・CFO、専務執行役員 堀 哲朗
- 事業環境および業績予想 代表取締役社長・CEO 河合 利樹

# 将来予想等に関する記述

- 将来見通しについて

本資料に記述されている当社の業績予想、将来予測などは、当社が作成時点で入手可能な情報に基づいて判断したものであり、経済情勢、半導体/FPD市況、販売競争の激化、急速な技術革新への当社の対応力、安全・品質管理、知的財産権に関するリスクなど、様々な外部要因・内部要因の変化により、実際の業績、成果はこれら見通しと大きく異なる結果となる可能性があります。

- 数字の処理について

記載された金額は単位未満を切り捨て処理、比率は1円単位の金額で計算した結果を四捨五入処理しているため、内訳の計が合計と一致しない場合があります。

- 為替リスクについて

当社の主力製品である半導体製造装置及びFPD製造装置の輸出売上は、原則円建てで行われます。一部にドル建ての決済もありますが、受注時に個別に先物為替予約を付し、為替変動リスクをヘッジしています。従って、収益への為替レート変動による影響は極めて軽微です。

- ガートナーのデータについて（18ページ）

本プレゼンテーションにおいてガートナーに帰属するすべての記述は、ガートナーの顧客向けに発行された配信購読サービスの一部として発行されたデータ、リサーチ・オピニオン、または見解に関する東京エレクトロンによる解釈であり、ガートナーによる本プレゼンテーションのレビューは行われておりません。ガートナーの発行物は、その発行時点における見解であり、本プレゼンテーション発行時点のものではありません。ガートナーの発行物で述べられた意見は、事実を表現したのではなく、事前の予告なしに変更されることがあります。

FPD:フラットパネルディスプレイ

# 第3四半期 連結決算の概要

2018年1月30日

堀 哲朗

代表取締役・CFO、専務執行役員



## FY2018 Q3（2017年10月～12月） ハイライト

- Q3業績は下期計画に沿って順調に進捗
  - データセンタ需要の高まりを背景に、SPEは引き続きメモリ向け投資が牽引
  - FPDでは第10.5世代への投資が始まる
- FPDセグメント利益率は19.0%、中期目標20%が視野に
- FS事業は幅広い世代で装置稼働率が上がり、拡大が続く

SPE：半導体製造装置、FPD：フラットパネルディスプレイ製造装置、FS：フィールドソリューション

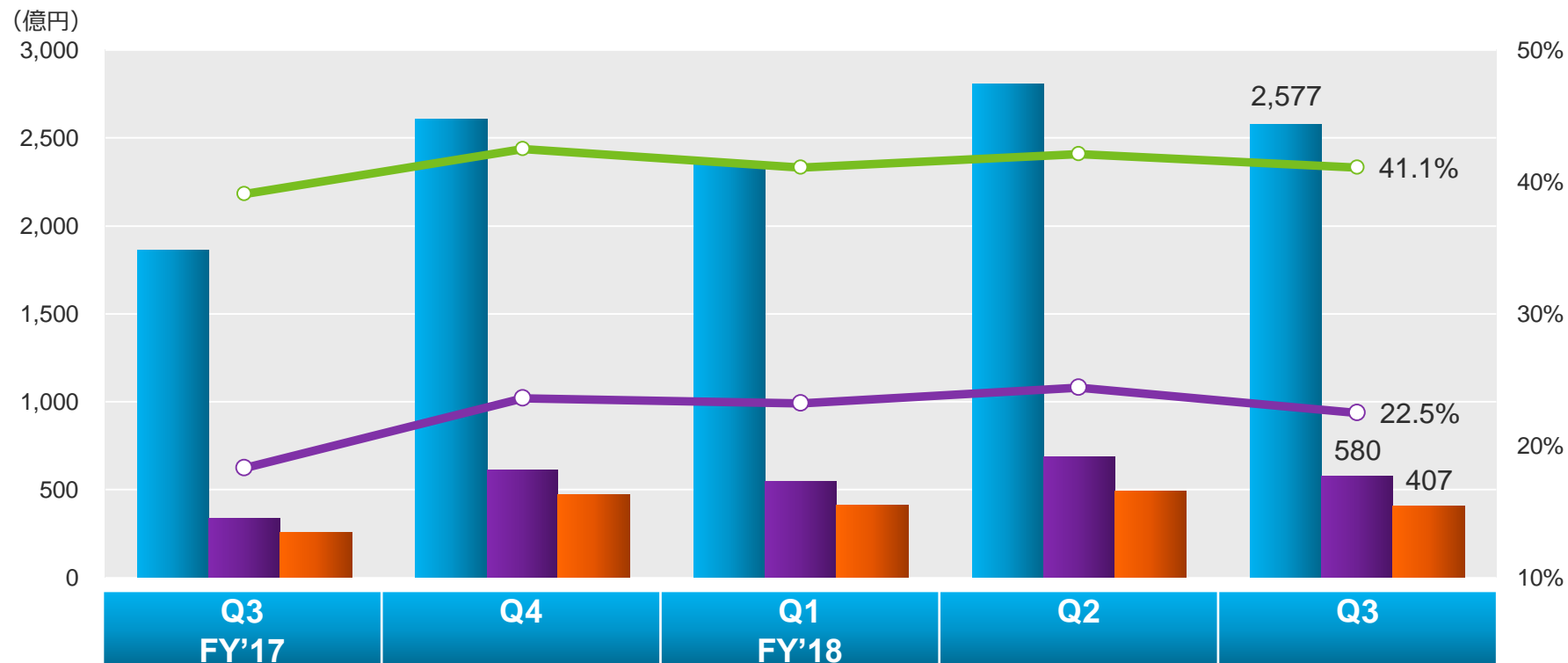
# 損益状況

(億円)

	FY2017		FY2018			対Q2 増減率
	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	
売上高	1,863	2,606	2,363	2,805	2,577	-8.1%
売上総利益 下段：売上総利益率	729 39.1%	1,106 42.5%	971 41.1%	1,182 42.1%	1,060 41.1%	-10.3% -1.0pts
販管費	387	491	423	497	479	-3.5%
営業利益 下段：営業利益率	341 18.3%	615 23.6%	547 23.2%	685 24.4%	580 22.5%	-15.2% -1.9pts
税前利益	332	614	551	671	573	-14.7%
親会社株主に帰属する 当期純利益	259	472	412	494	407	-17.6%
研究開発費	191	248	211	248	239	-3.7%
設備投資額	41	71	81	117	137	+17.5%
減価償却費	45	50	42	47	55	+15.2%

1. 当社の主力製品である半導体製造装置及びFPD製造装置の輸出売上は、原則円建てで行われます。  
一部にドル建ての決済もありますが、受注時に個別に先物為替予約を付し、為替変動リスクをヘッジしています。
2. 利益率および増減率は、1円単位の金額をもとに計算しています。

# 損益状況

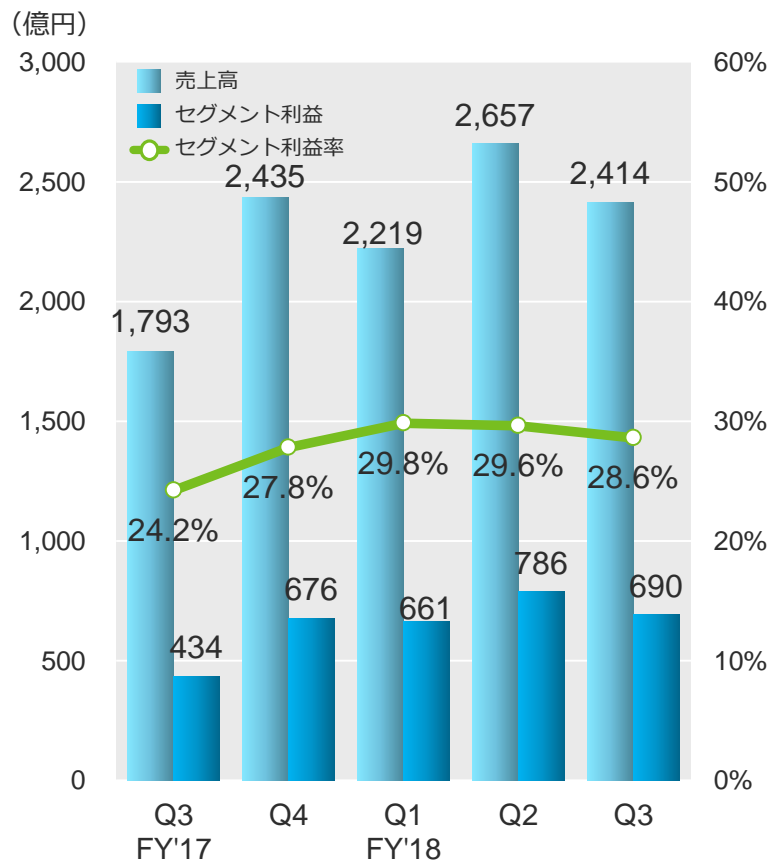


	Q3 FY'17	Q4	Q1 FY'18	Q2	Q3
売上高	1,863	2,606	2,363	2,805	2,577
営業利益	341	615	547	685	580
親会社株主に帰属する 当期純利益	259	472	412	494	407
売上総利益率	39.1%	42.5%	41.1%	42.1%	41.1%
営業利益率	18.3%	23.6%	23.2%	24.4%	22.5%

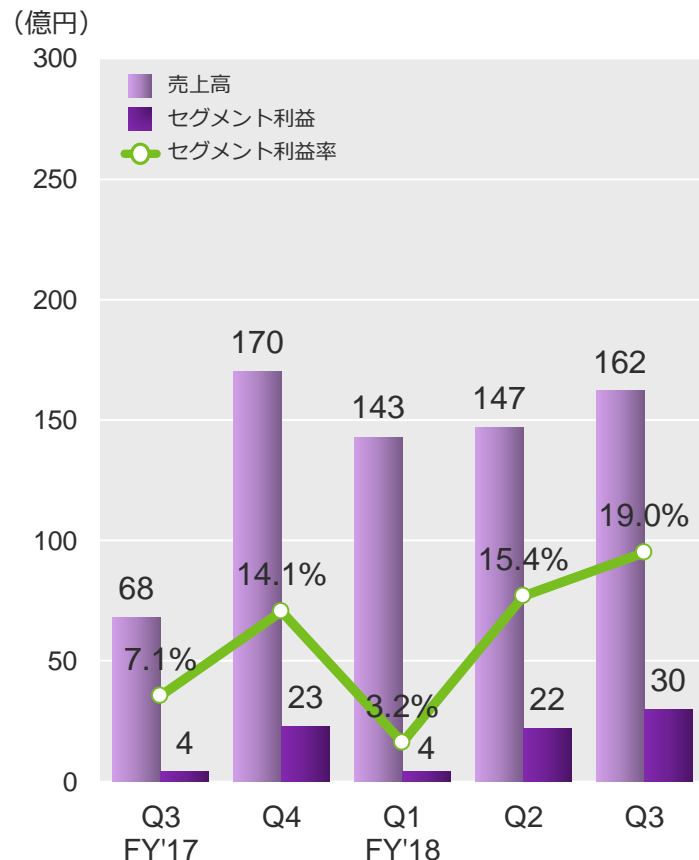
売上総利益率・営業利益率ともに計画通り推移

# セグメント情報

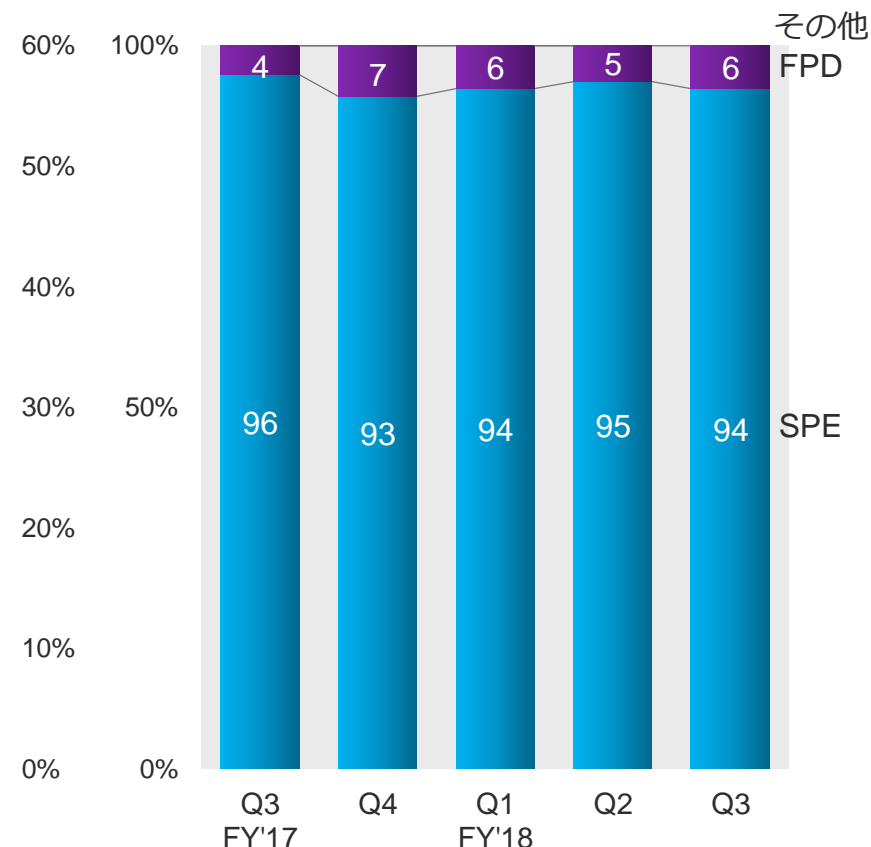
## SPE (半導体製造装置)



## FPD (フラットパネルディスプレイ製造装置)

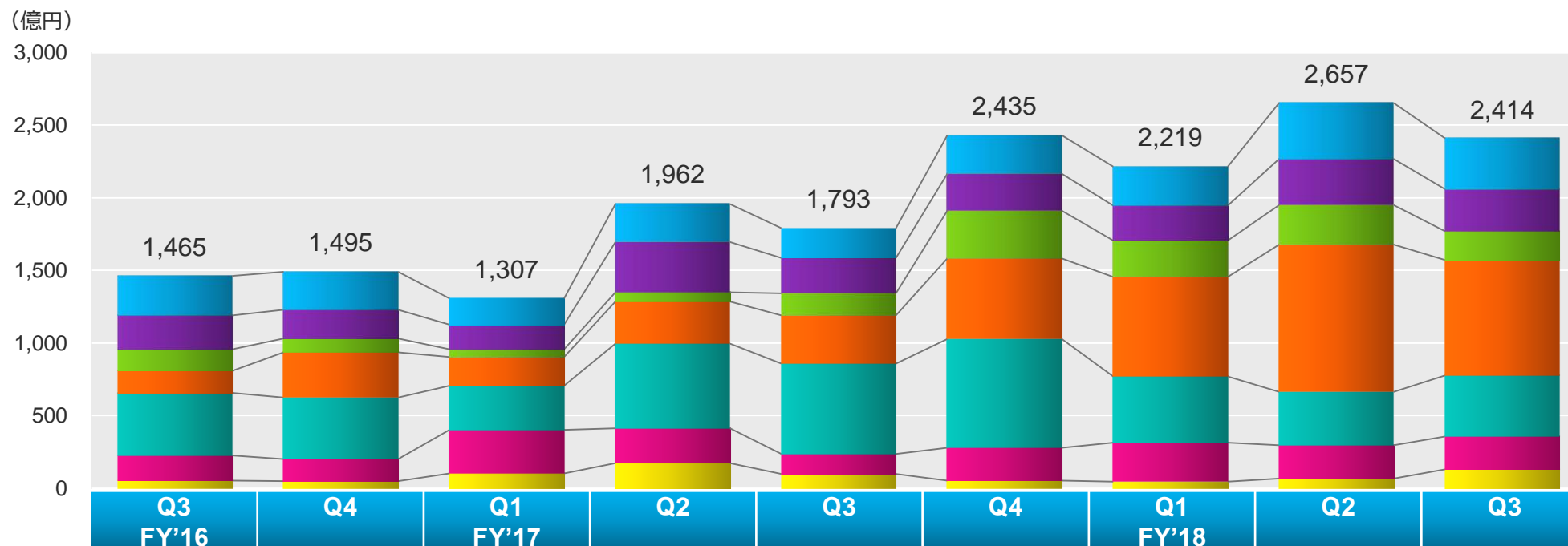


## 売上構成比率



1. セグメント利益は、税前利益です。
2. 上記報告セグメントに配分していない全社費用（主に基礎研究又は要素研究等の研究開発費）があります。
3. 売上構成比率は外部顧客に対する売上高で算出しています。

# SPE部門 地域別売上高

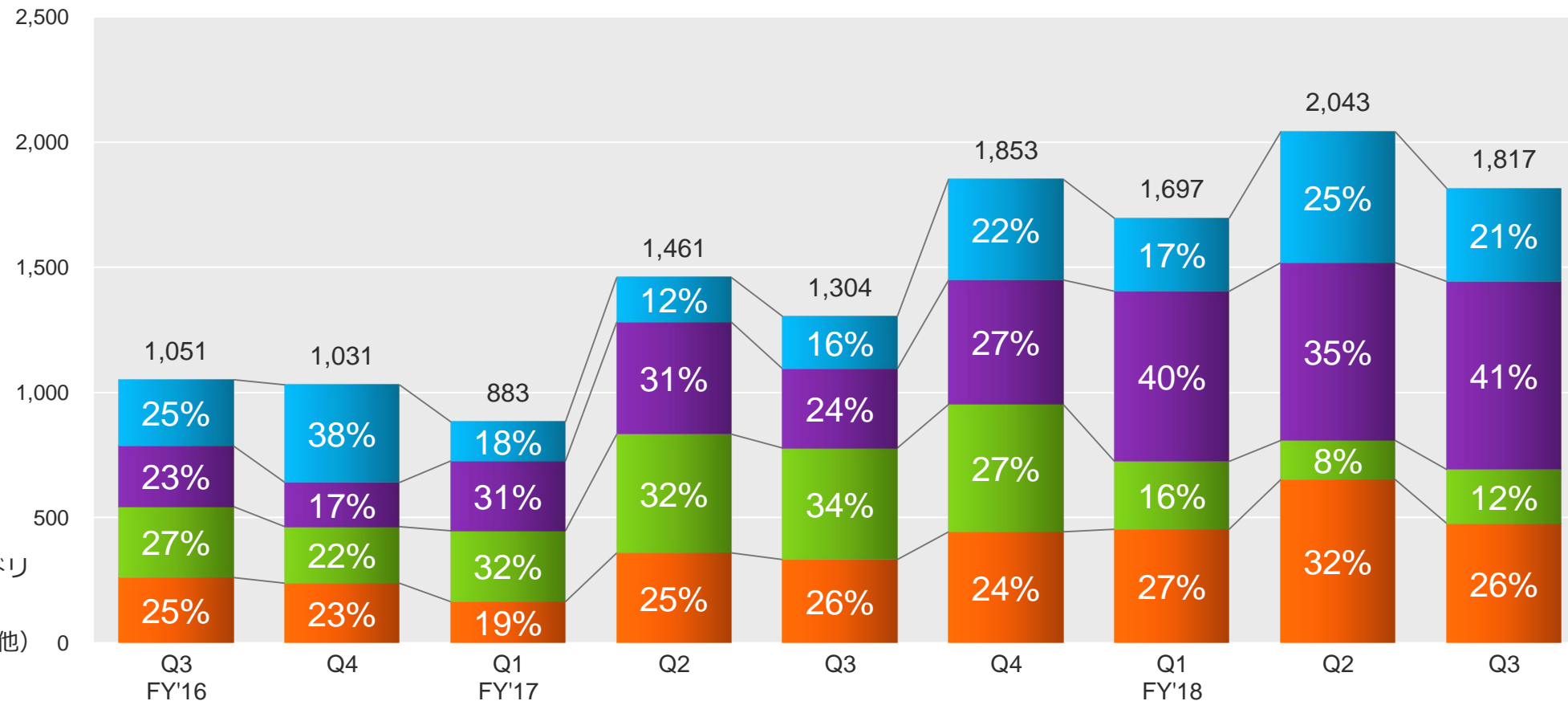


	Q3 FY'16	Q4	Q1 FY'17	Q2	Q3	Q4	Q1 FY'18	Q2	Q3
日本	270	264	178	264	203	266	267	384	351
北米	234	197	170	344	246	254	240	320	291
欧州	148	95	52	66	150	329	253	269	196
韓国	152	309	198	290	333	555	683	1,017	794
台湾	433	425	305	582	623	747	458	366	421
中国	172	152	300	240	137	227	267	230	226
東南アジア・他	53	50	103	173	98	53	46	67	132



# SPE部門 新規装置 アプリケーション別売上構成比

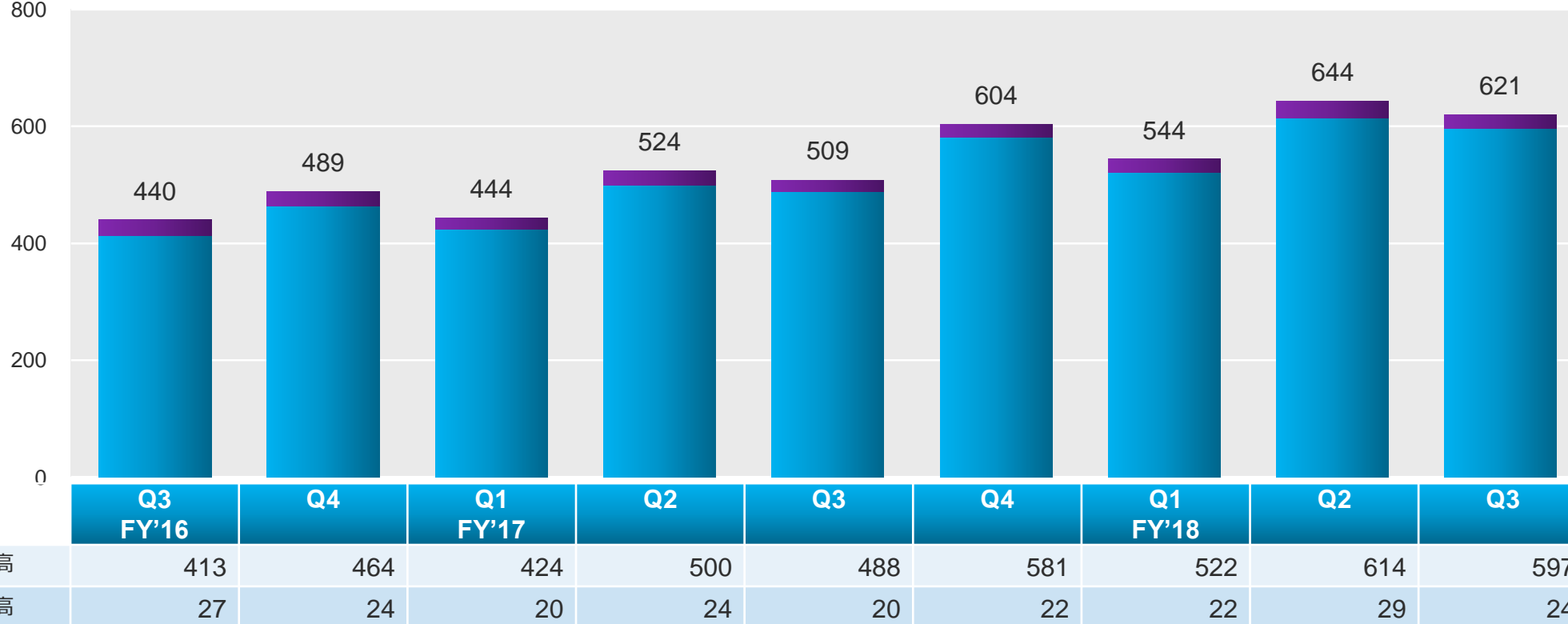
(億円)



不揮発性メモリ向けの投資が高水準継続

# フィールドソリューション売上高

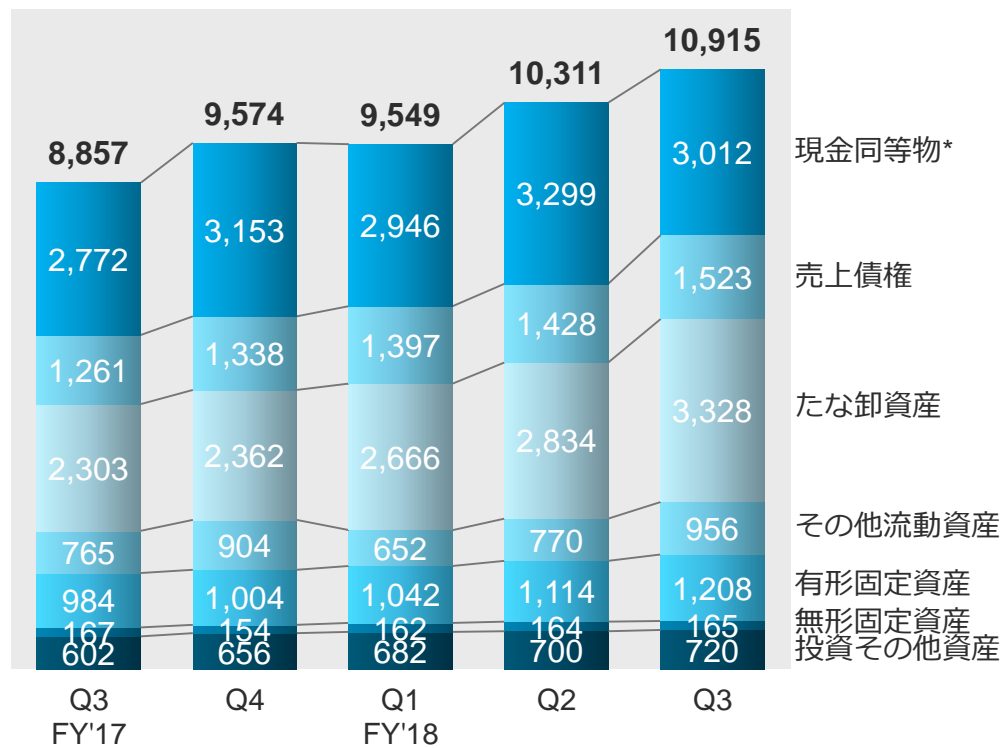
(億円)



# 貸借対照表

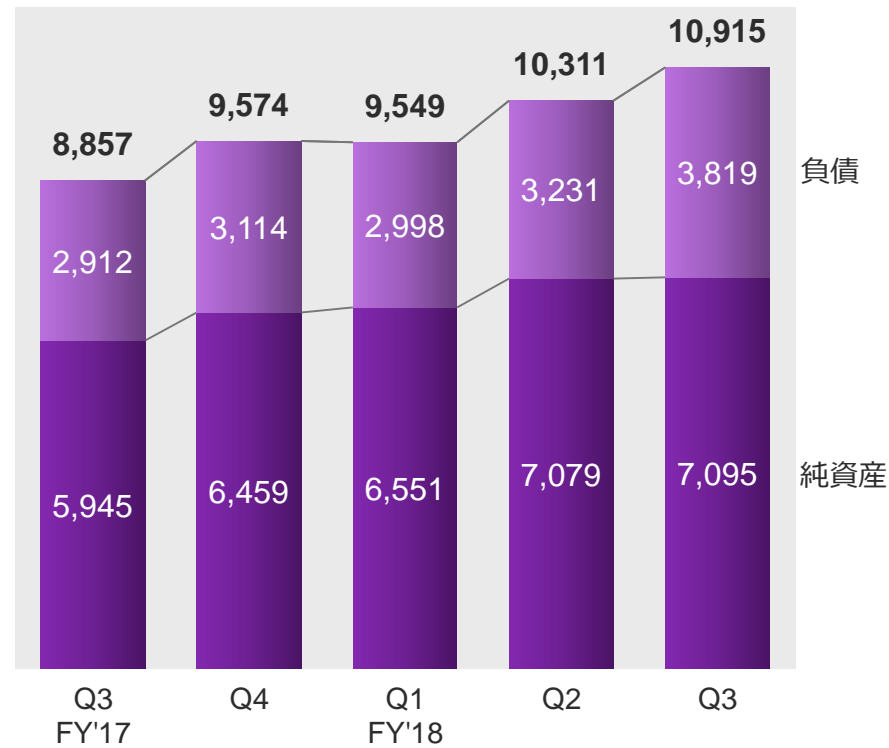
## 資産

(億円)



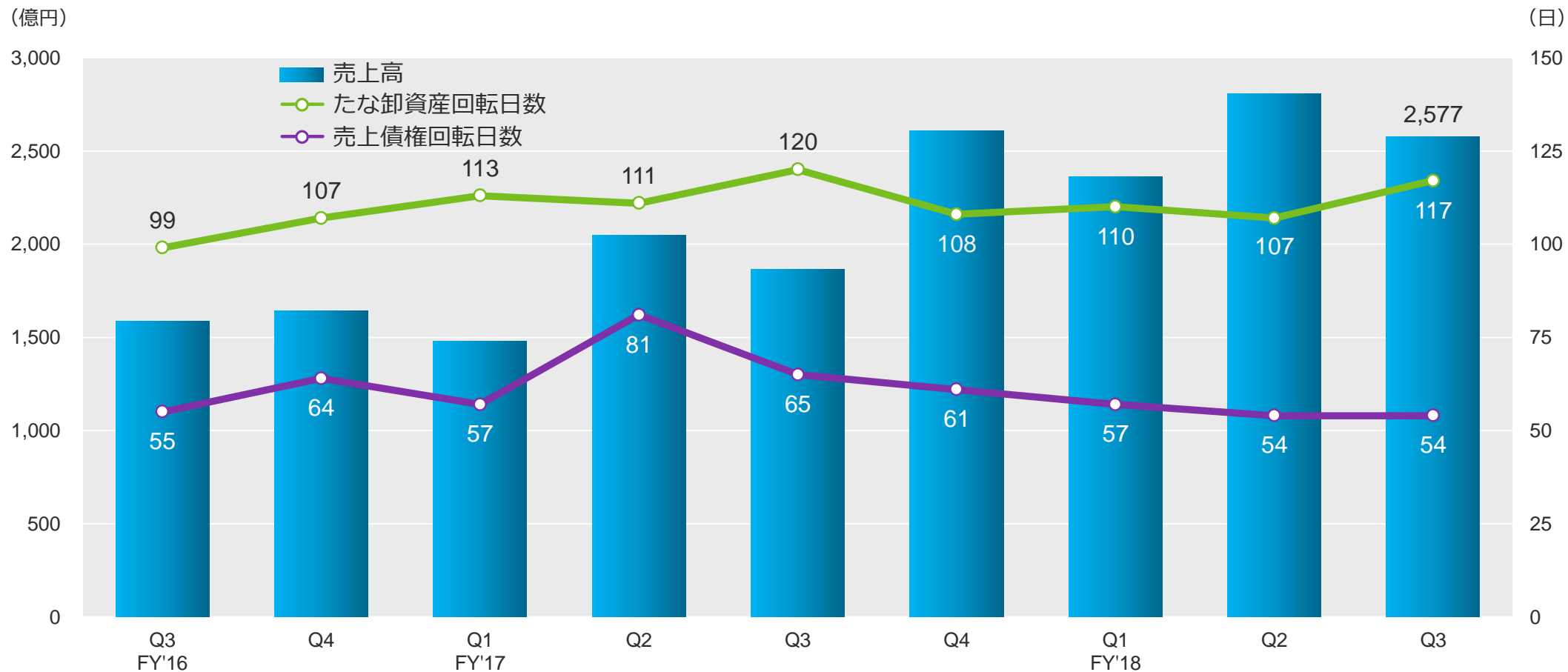
## 負債・純資産

(億円)



\* 現金同等物：現預金 + 短期投資等（貸借対照表上の表示は有価証券）

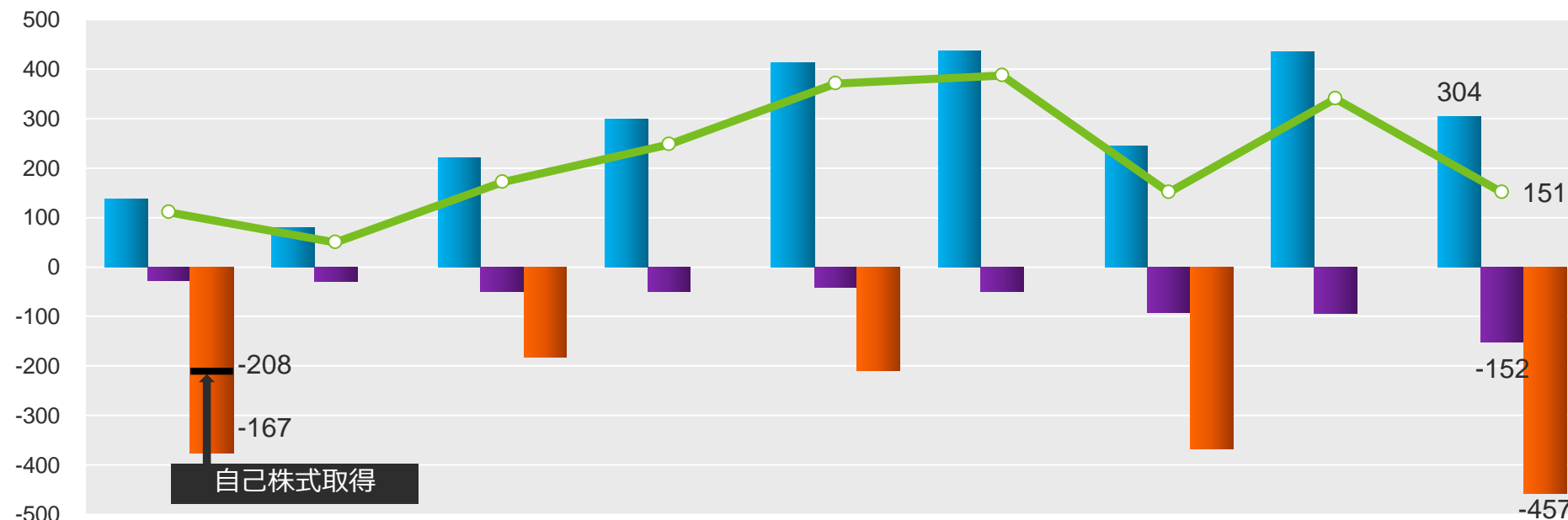
# たな卸資産・売上債権の回転日数



回転日数 = 売上債権もしくはたな卸資産 ÷ 各四半期末までの12ヶ月間売上高 × 365

# キャッシュ・フロー

(億円)



	Q3 FY'16	Q4	Q1 FY'17	Q2	Q3	Q4	Q1 FY'18	Q2	Q3
営業キャッシュ・フロー	138	79	221	298	413	436	244	434	304
投資キャッシュ・フロー*	-27	-29	-49	-49	-41	-49	-93	-94	-152
財務キャッシュ・フロー	-375	0	-183	0	-210	-0	-368	-0	-457
フリーキャッシュ・フロー**	111	50	172	248	371	387	151	340	151
手元資金残高***	2,338	2,366	2,309	2,556	2,772	3,153	2,946	3,299	3,012

\* 投資キャッシュ・フローは、満期3ヶ月超の預金等の増減額を除いた金額です。

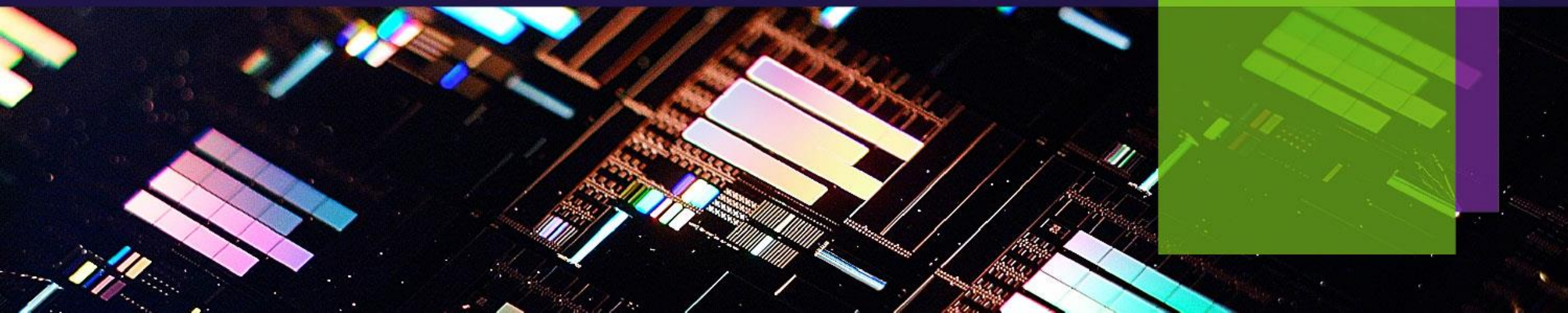
\*\* フリーキャッシュ・フロー = 営業活動によるキャッシュ・フロー + 投資活動によるキャッシュ・フロー (満期3ヶ月超の預金等の増減額を除く)

\*\*\* 手元資金とは、現金及び現金同等物と満期3ヶ月超の預金等の合計金額です。

# 事業環境および業績予想

2018年1月30日

河合 利樹  
代表取締役社長・CEO



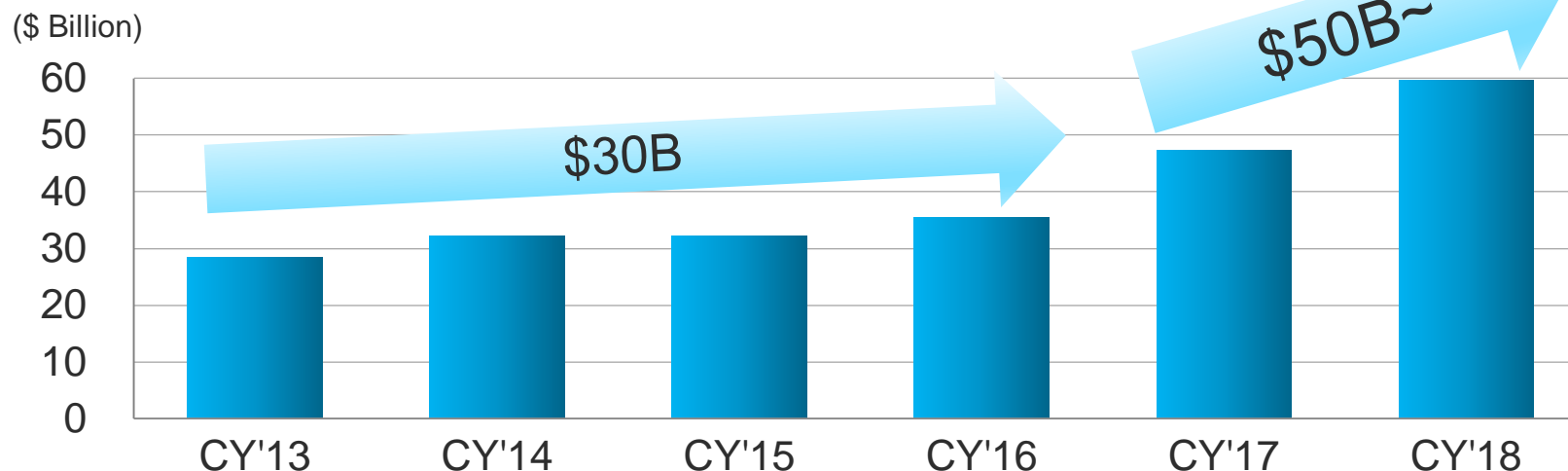
# 半導体前工程製造装置(WFE)市場の展望

## 将来の成長ドライバー

PC・インターネット・モバイル  
+  
VR/AR/MR\*・IoT・AI・RPA\*\*・機械学習  
ビッグデータ・自動運転・個別化医療

\*VR/AR/MR：仮想現実/拡張現実/複合現実 \*\*RPA：ロボットによる処理自動化

WFE市場の成長加速  
\$50B以上へ拡大



半導体用途の広がりにより、装置市場は一段上のフェーズへ

## 事業環境（2018年1月時点での見方）

### ▶ 半導体前工程製造装置(WFE)\* の設備投資

CY2018の投資額は、旺盛なメモリー向け需要に牽引され、前年比10%程度の成長を見込む。

### ▶ FPD製造装置 TFTアレイ工程\*\* 向け設備投資

CY2018の装置需要は、モバイル用途の中小型パネル向け設備投資の継続と第10.5世代向けの投資拡大により、前年比20%程度の成長を予想。

装置市場は、IoTと次世代技術への活発な投資により成長が加速

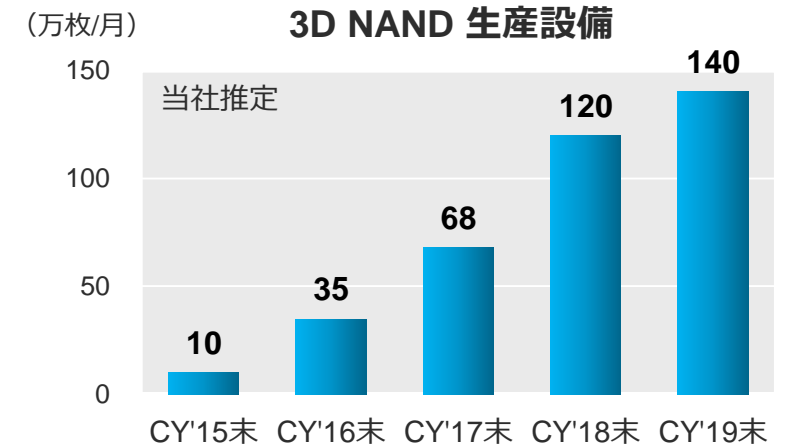
\* 半導体前工程製造装置（WFE; Wafer fab equipment）：半導体製造工程には、ウェーハ状態で回路形成・検査をする前工程と、そのウェーハをチップごとに切断し、組み立て・検査をする後工程があります。半導体前工程製造装置は、この前工程で使用される製造装置です。また半導体前工程製造装置は、ウェーハレベルパッケージング用の装置を含んでいます。

\*\* TFTアレイ工程：ディスプレイを駆動する電気回路機能を持つ基板を製造する工程



# CY2018 アプリケーション別のWFE市場と事業機会

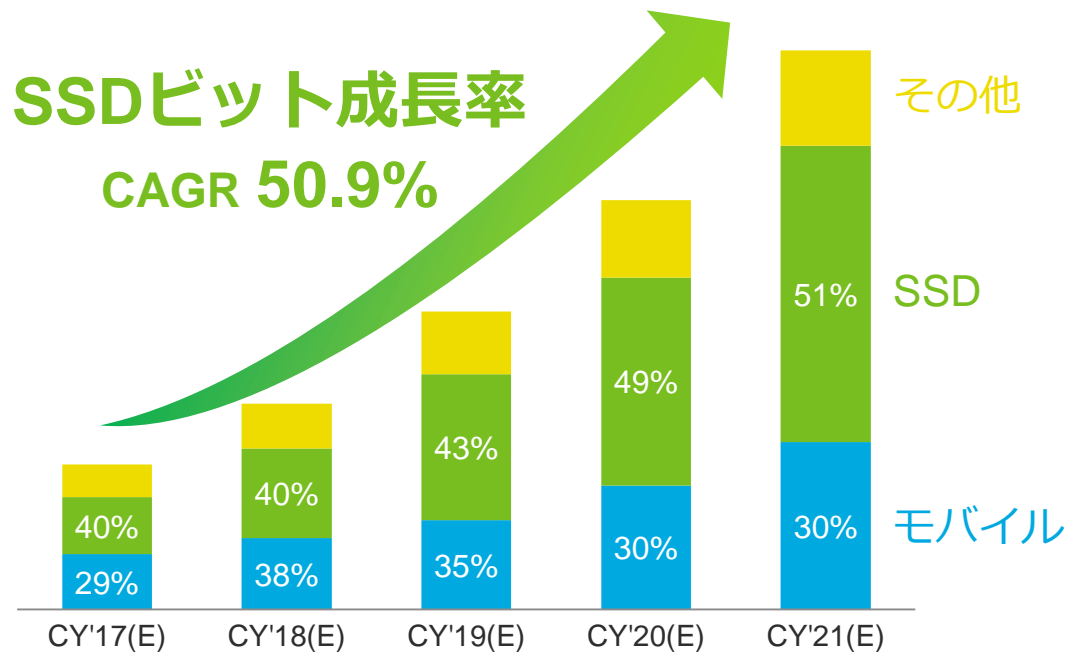
- NAND：前年比5%の市場成長を予想
  - 設備投資：最先端の9X層数世代向けが5割
  - 牽引役：データセンタ向けSSD需要の拡大
  - 事業機会：高付加価値のエッチング工程で差別化
- DRAM：30%以上の増加
  - 設備投資：1X/1Ynm世代向け設備投資が8割
  - 牽引役：モバイルの平均搭載容量は前年比25%増加、サーバも30%増加
  - 事業機会：一括パターンニング、配線工程で差別化
- ロジック/ファウンドリ：同水準を予想
  - 設備投資：10nm以細の世代向けが6割
  - 牽引役：高性能化、省エネ化の需要
  - 事業機会：難易度の高まるパターンニングでのビジネス拡大



# NANDフラッシュ向け設備投資の牽引役

## NANDビット需要のアプリケーション別構成比

\*グラフ上の比率はビット需要全体を100とした場合の構成比



Source: Gartner, "Forecast: NAND Flash Supply and Demand, Worldwide, 1Q16-4Q18, 4Q17 Update", 02 January 2018.  
 図はガートナーリサーチに基づき、東京エレクトロンが作成。  
 モバイル: Ultramobile + Phone, Basic, Smart OS + Phone, Premium, Smart OS + Phone, Utility, Smart OS, CAGR: CY'17-CY'21

- NANDビット成長はSSDが牽引
  - SSD CAGR 50.9% (CY'17-21)
  - モバイル CAGR 32.0% (CY'17-21)
- サーバ容量の需要が急増
  - ※容量はSSDとHDD合計
  - CY'17 300EB ⇒ CY'21 1ZB EB: 10<sup>18</sup> byte, ZB: 10<sup>21</sup> byte
- SSD搭載率の成長ポテンシャル大
  - CY'17 サーバ向けSSD搭載率は僅か9%
  - CY'17 PC向けSSD搭載率も39%

Source: Gartner, "Forecast: Hard-Disk Drives, Worldwide, 2014-2021, 3Q17 Update", 13 November 2017.  
 サーバ: Total Enterprise HDD/SSD PB, PC: Total Notebook/Ultramobile Premium and Desk-Based/Workstation PCs

## IoTによるストレージ需要急増とSSD搭載率増加の両方が投資を牽引

## FY2018 SPE事業の進捗

- 市場拡大とシェア向上により、メモリ向け通期売上予定が前期比2倍
- FS事業の収益拡大、9ヶ月累計売上高1,810億円、前年同期比22%の増加\*
- 戦略製品の売上拡大も順調
- 宮城工場（エッチング装置）の拡張
  - 物流棟の稼働開始
  - 新開発棟 9月竣工予定
  - 生産能力を10月までに2倍に増強

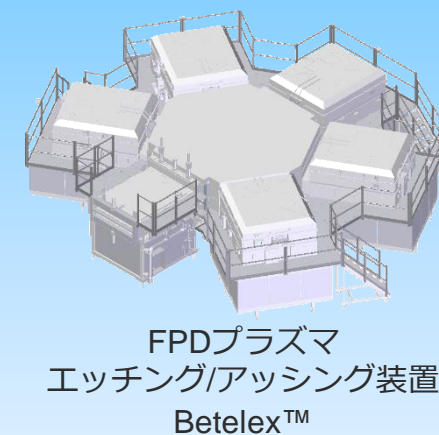
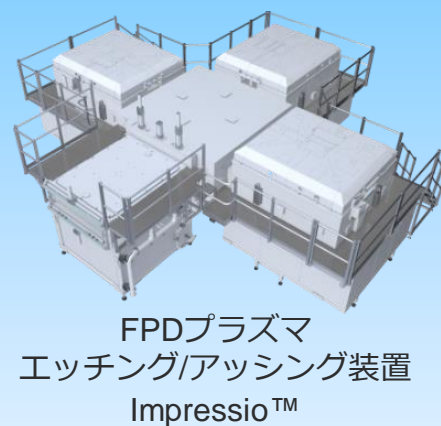
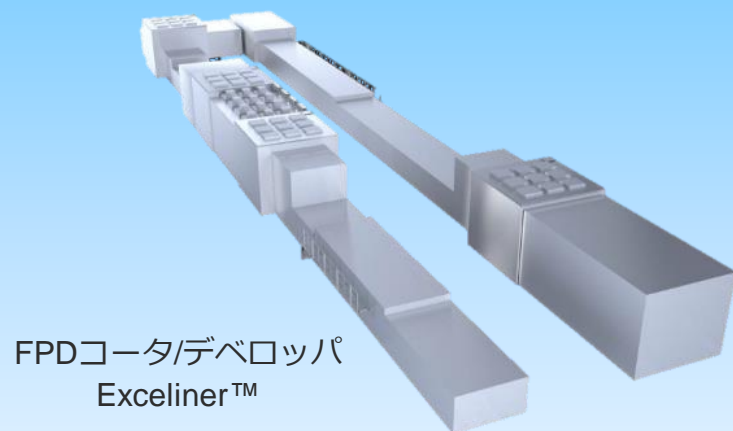


東京エレクトロン宮城

SPEの事業戦略は計画通り進捗、次世代向け技術で収益拡大

## FY2018 FPD事業の進捗

- 第10.5世代におけるリーディングポジション確立
- 新プラットフォーム エッチング装置 Betelex™を投入
- PICP™\*エッチング装置の製品展開が好調
  - 中小型向け通期売上予定が前期比約2倍、大型向けにもビジネス獲得



FPDの事業戦略は順調に進捗、計画通りの利益率向上を見込む

# FY2018 業績予想

# FY2018 業績予想 (2017/10/31発表から変更なし)

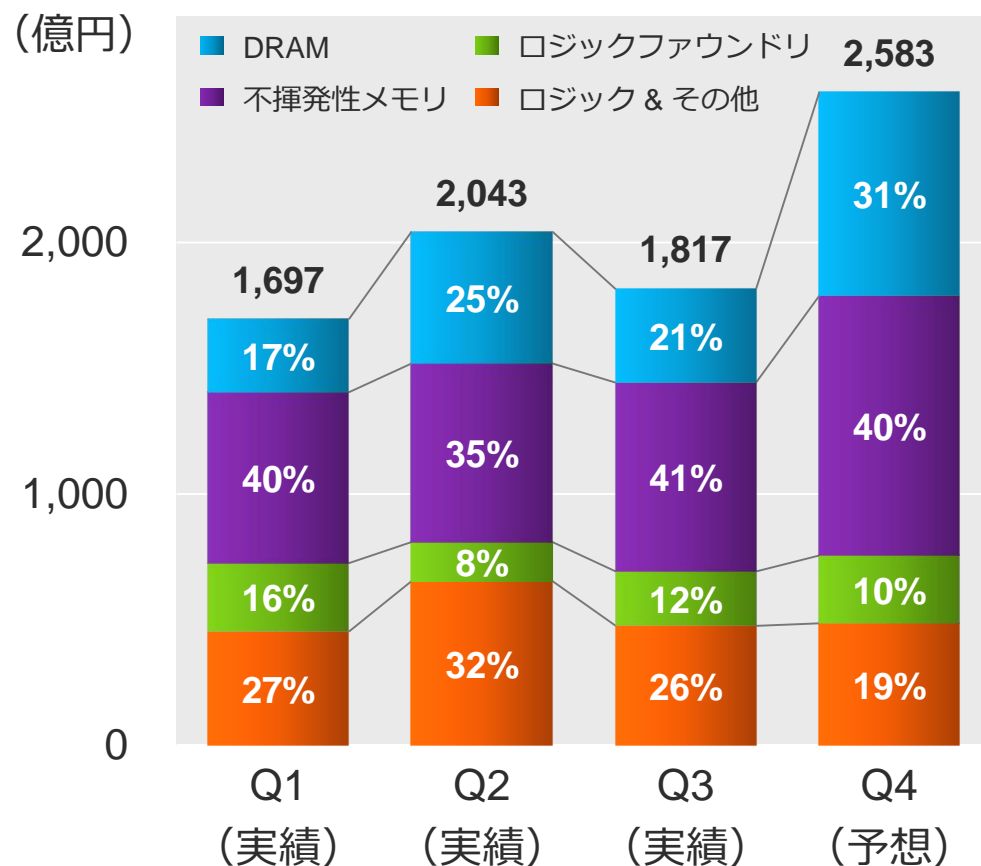
(億円)

	FY2017 (実績)	FY2018 (予想)				通期 対前年増減
		H1	H2	通期	通期 対前年増減	
		実績	予想	予想		
売上高	7,997	5,169	6,130	11,300	+41.3%	
SPE	7,498	4,877	5,670	10,547	+40.6%	
FPD	493	290	459	750	+51.9%	
売上総利益 下段：売上総利益率	3,222 40.3%	2,154 41.7%	2,515 41.0%	4,670 41.3%	+1,447 +1.0pts	
販管費	1,665	920	1,039	1,960	+294	
営業利益 下段：営業利益率	1,556 19.5%	1,233 23.9%	1,476 24.1%	2,710 24.0%	+1,153 +4.5pts	
税前利益	1,491	1,223	1,447	2,670	+1,178	
親会社株主に帰属する 当期純利益	1,152	906	1,073	1,980	+827	
1株当たり当期純利益 (円)	702.26	552.59	-	1,206.66	+504.40	

投資拡大とシェア向上により、大幅な増収増益を見込む

# FY2018 SPE部門 新規装置売上予想

FY2018 アプリケーション別売上構成比

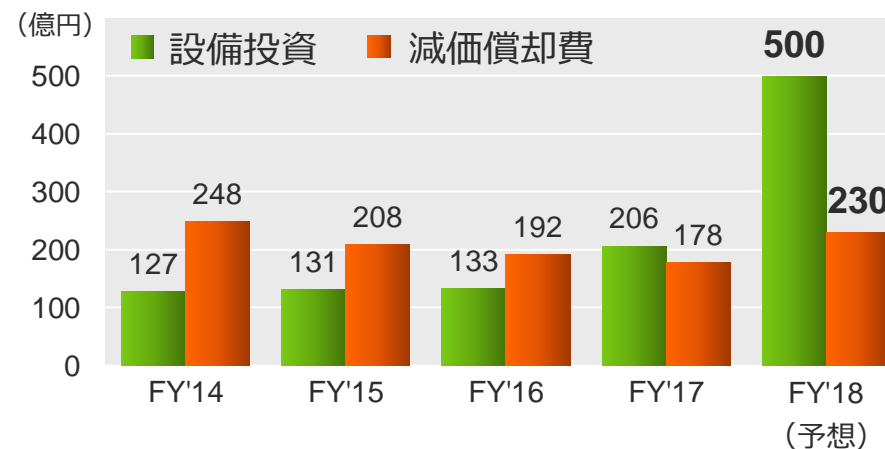
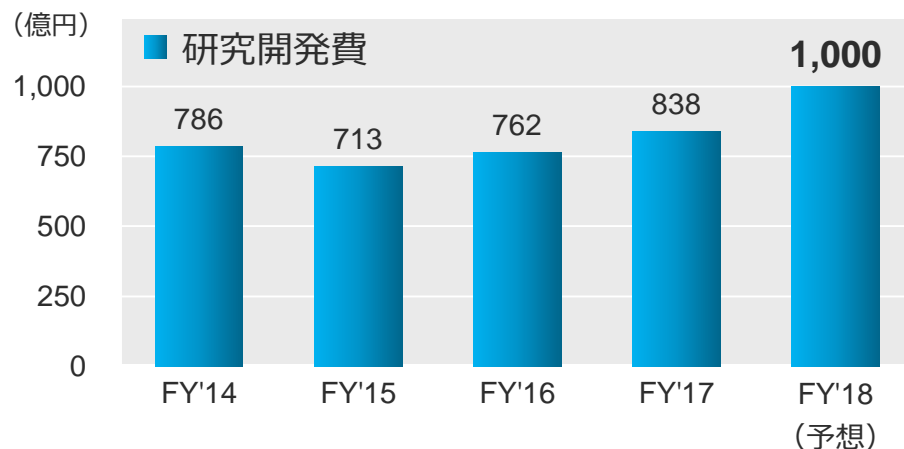


- DRAM
  - 需給タイトにより投資急拡大
- 3D NAND
  - SSD向け需要好調
  - 次世代9X向け装置の納入開始
- ロジック/ファウンドリ
  - 10/7nm世代への投資継続
  - 28nm世代以前への投資も堅調

グラフは新規装置の売上高における構成比を示しています。フィールドソリューション売上高を含んでいません。また、Q4予想の2,583億円は10月31日発表の下期予想値からQ3実績を引いた値です。

# FY2018 研究開発費・設備投資計画（2017/10/31発表から変更なし）

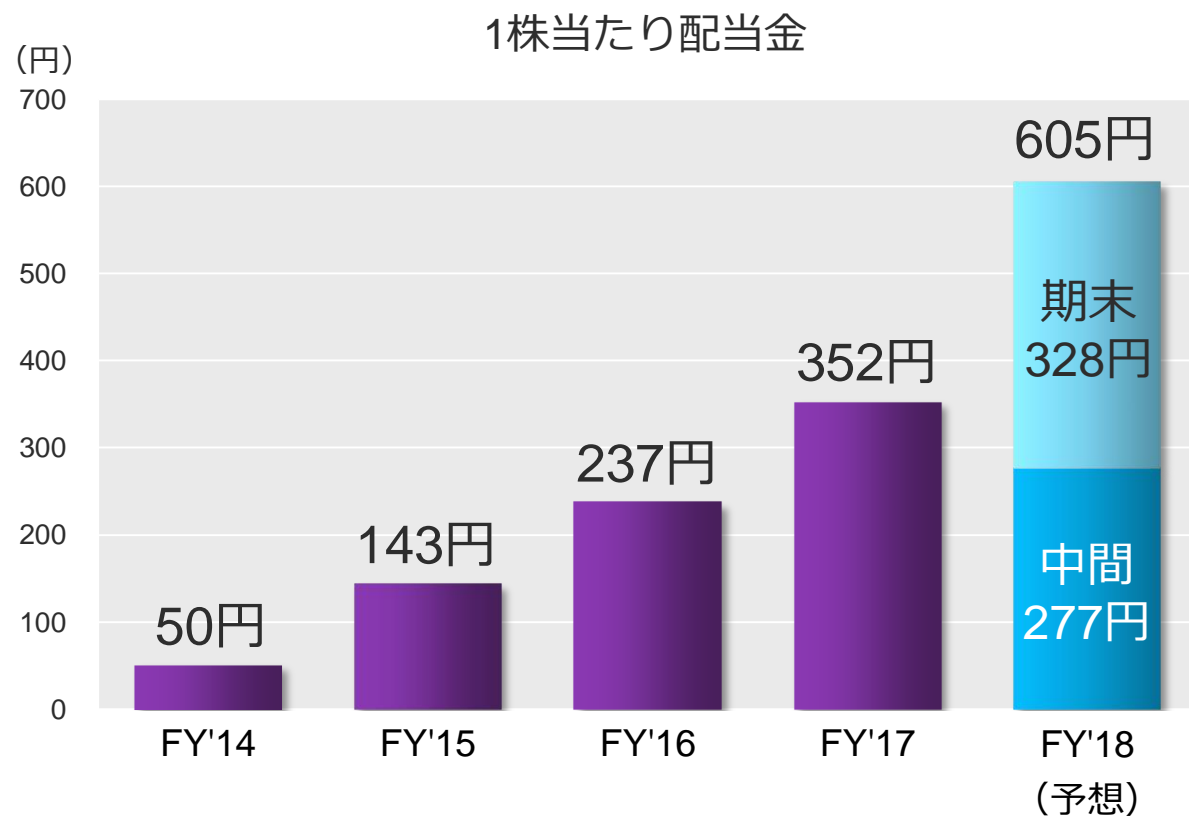
- 開発費 1,000億円
  - 注力分野および持続的成長を見据えた投資継続
- 設備投資 500億円
  - 先端技術開発・増産対応への積極的な投資
- 減価償却費 230億円



装置市場の新たなフェーズに向けた積極的な先行投資を予定



# FY2018 配当予想 (2017/10/31発表から変更なし)



## 当社の株主還元策

連結配当性向： 50%

但し、1株当たり年間配当金150円を下回らない

2期連続して当期利益を生まなかった場合は、配当金の見直しを検討する

自己株式の取得： 機動的に実施を検討

1株当たり配当金は、前期比70%以上の増配を予定

## FY2019に向けてのキーメッセージ

- CY2018は更なる市場成長を見込む（WFE市場+10%、FPD装置市場+20%）
- SPE/FPD事業とともに、市場成長をアウトパフォームする
- 拡大する装置市場に対する積極的な開発投資の継続
- 5nm世代以細に向けたプロセス インテグレーションの開発加速
- IoTアプリケーションに対応したFS事業の拡大

# 補足資料

## FY2018 Q1-Q3累計（2017年4月～12月） ハイライト

- 市場成長・当社シェア向上により、売上は過去最高の7,747億円（前年同期比+44%）
  - メモリ向けSPE新規装置の売上が2倍以上
  - FS事業の売上も伸長し、1,810億円（前年同期比+22%）
- 売上総利益率・営業利益率ともに大きく向上（前年同期比+2.2pts, +5.9pts）
  - 各製品の収益性向上に向けた施策が実る
  - 売上の伸びに対し、コスト増加を抑制
- 通期配当は過去最高の1株当たり605円を予定

# 損益状況

(億円)

	FY2017	FY2018	対前年同期 増減率
	Q1-Q3累計	Q1-Q3累計	
売上高	5,390	7,747	+43.7%
売上総利益 下段：売上総利益率	2,116 39.3%	3,214 41.5%	+51.9% +2.2pts
販管費	1,174	1,400	+19.3%
営業利益 下段：営業利益率	941 17.5%	1,814 23.4%	+92.7% +5.9pts
税前利益	876	1,796	+105%
親会社株主に帰属する 当期純利益	679	1,313	+93.4%
研究開発費	589	700	+18.7%
設備投資額	135	335	+148.1%
減価償却費	127	145	+13.7%

1. 当社の主力製品である半導体製造装置及びFPD製造装置の輸出売上は、原則円建てで行われます。  
一部にドル建ての決済もありますが、受注時に個別に先物為替予約を付し、為替変動リスクをヘッジしています。
2. 利益率および増減率は、1円単位の金額をもとに計算しています。

**TEL**™

**TOKYO ELECTRON**